开标情况记录表

标段编号：2606-440306-04-01-921232001001
标段名称：高端存储芯片封装测试及先进封装产业基地项目（设计）
开标时间：2026-11-11 09:30:00
开标地点：无
招标人：深圳沛顿半导体封测有限公司
招标代理：公诚管理咨询有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	设计周期	不予受理情况
1	世源科技工程有限公司	√	√	770.198	按招标文件执行	
2	中国建筑科学研究院有限公司	√	√	636.8115	按招标文件执行	
3	中国电子系统工程第四建设有限公司	√	√	869.23631	按招标文件执行	
4	中赣工程设计有限公司	√	√	1070.013	按招标文件执行	
5	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	√	√	1083.4735	按招标文件执行	
6	合力建设工程（成都）有限公司	√	√	647.0720	响应招标文件要求	
7	奥意建筑工程设计有限公司	√	√	812.8400	按招标文件执行	
8	深圳壹创国际工程设计股份有限公司	√	√	1090.5340	按招标文件执行	
9	深圳大学建筑设计研究院有限公司	√	√	881.4635	设计周期为收到任务书之日起90个日历天完成方案设计并报审，45日历天内完成施工图设计，其他设计阶段详见合同条款。	

招标人签名： 2026年11月11日